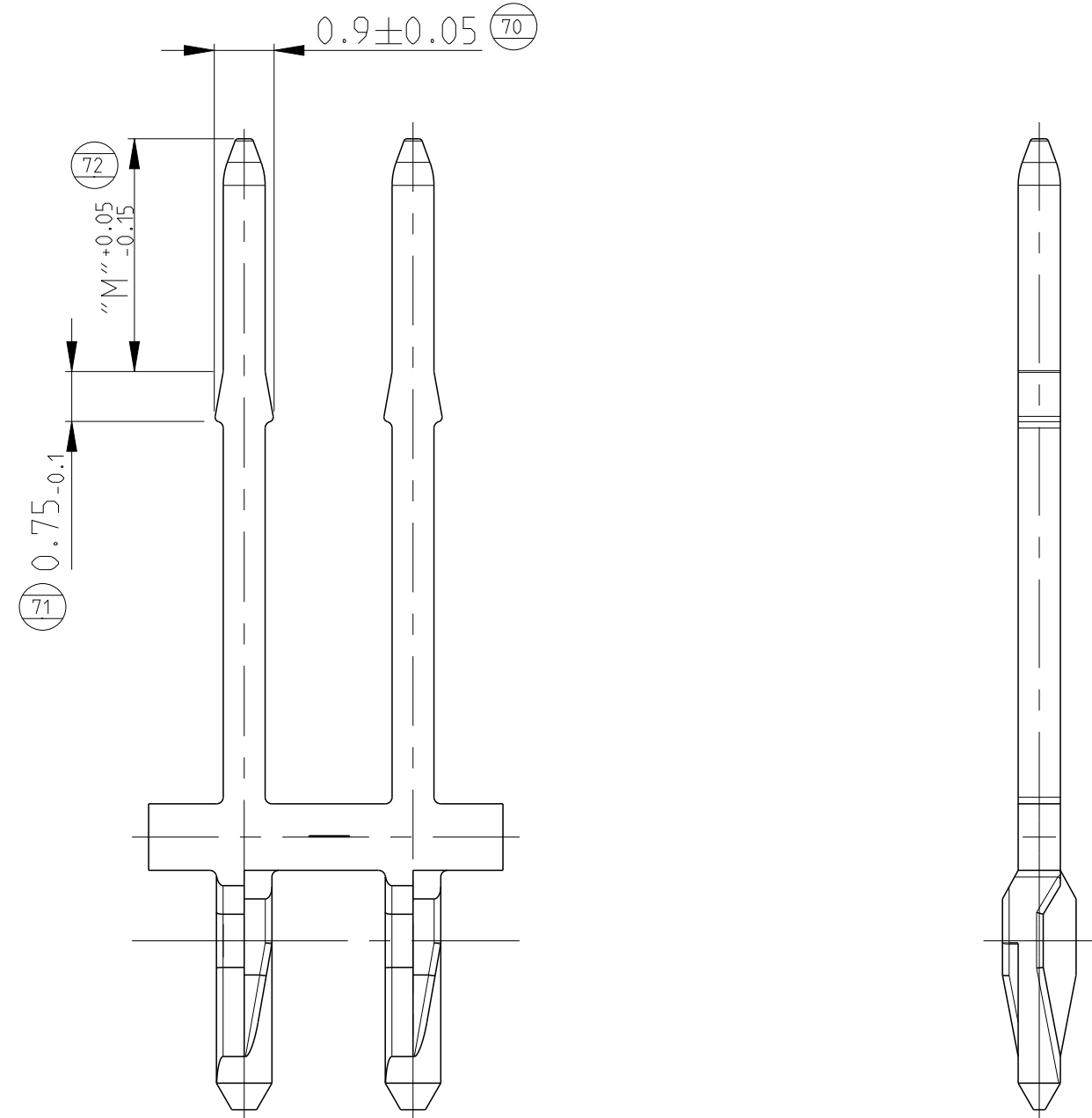


VERSION B



3 -
4 Loetbarkeit nach DIN 40046
SOLDERABILITY ACCORDING TO DIN 40046

⁷ Zulaessige Saebelfoermigkeit: 40mm/m
PERMITTED SABERSHARPNESS: 40mm/m

 Einpresszone fuer 1.6mm Leiterplatte
Anforderung an Leiterplattenloch, siehe Tabelle 1
PRESS-IN AREA FOR 1.6mm PCB
REQUIREMENTS ON PCB HOLE. SEE TABLE 1

9. Verpackungseinheit: 50.000 Stck. auf Einweg Kunststoff-Spule Ø 588mm
mit Zwischenlagenpapier, 3 Spulen im Karton
PACKAGING UNIT: 50.000 PCS ON ONE-WAY PLASTIC REEL DIA.588MM
WITH INTERLEAVING PAPER, 3 REELS IN BOX.

 10 Lochaufbau (Zinn/Blei) in der Leiterplatte (siehe Tabelle 1)
HOLE CONSTRUCT (TIN/LEAD) FOR PCB (SEE TABLE 1)

11) Lochaufbau (Nickel/Gold) in der Leiterplatte (siehe Tabelle 1)
HOLE CONSTRUCT (NICKEL/GOLD) FOR PCB (SEE TABLE 1)

Lochaufbau (Zinn) in der Leiterplatte (siehe Tabelle 1)
HOLE CONSTRUCT (TIN) FOR PCB (SEE TABLE 1)

 Verdrehung Action Pin Spitze max. 30 °
DISTORTION OF ACTION PIN TIP MAX. 30 DEG.

Material spezifiziert nach UNS C19002
MATERIAL SPECIFIED ACCORDING TO UNS C19002

 Spulen mit Kunststoff-Spule PN 1-1498100-8 mit
Zwischenlagenpapier PN 1-740973-2. Transportkarton 973051-2

REELE ONTO PLASTIC REEL PN 1-1498100-8 WITH INTERLEAVING
PAPER PN 1-740973-2. SHIPPING CARTON 973051-2

 REELED ONTO REEL PN 725654-9 WITH
INTERLEAVING PAPER PN 740973-3. SHIPPING
CARTON 973051-2
Spulen mit Spule PN 725654-9 mit
Zwischenlagenpapier PN 704973-3. Transportkarton 973051-2

1.3 μm TO 2.5 μm NICKEL UPON PLATING AFTER FORMING SEQUENCE
1.3 μm bis 2.5 μm Nickel nach Formgebung ueber alles

Loch Aufbau in der Leiterplatte
HOLE CONSTRUCT FOR PCB

45°

Ueberstand min. 50 μm
RESTRING MIN. 50 μm

(110)

Lochaufbau in der Leiterplatte

Tabelle 1 TABLE 1		Durchplattierte Bohrung, Spezifikation PLATING ACROSS OF HOLE, SPEC.		
Lochaufbau LP HOLE CONSTRUCT PCB				
Kupferschicht COPPER COATING	25-75 µm	25-75 µm	25-50 µm	
Zinn/Blei Schicht TIN/LEAD COATING	4-10 µm	-	-	
Zinn Schicht TIN COATING	-	-	0.5-1.5 µm	
Nickel Schicht NICKEL COATING	-	max. 5 µm	-	
Gold Schicht GOLD COATING	-	max. 0.2 µm	-	
Bohr Ø HOLE DIA.	1.15±0.025	1.15±0.025	1.15±0.025	
Plattierter Ø PLATED DIA.	1 ^{+0.09} _{-0.06}	1 ^{+0.09} _{-0.06}	1.07 ^{+0.055} _{-0.045}	

Tabelle 2
TABLE 2

Oberflaeche/SURFACE

Zone "I" AREA	Goldausführung: 0.8 µm bis 2 µm Au ueber Ni GOLD VERSION: 0.8 µm TO 2 µm Au OVER Ni Zinn-Ausführung: 1 µm bis 3 µm Sn TIN-VERSION: 1 µm TO 3 µm Sn SILVER-VERSION 1.5 µm to 5 µm Ag over Ni
Zone "II" AREA	Schichtdicke: 1.3 µm bis 2.2 µm Ni COAT THICKNESS: 1.3 µm TO 2.2 µm Ni FOR PN 8-963964-8 regarding note 
Zone "III" AREA	Schichtdicke: 0.8 µm bis 1.8 µm Sn ueber Ni COAT THICKNESS: 0.8 µm TO 1.8 µm Sn OVER Ni

THE PN 8-963964-8 is in development status
The 8-963964-8 is not released for serial production

PN 8-963964-8 ist in dem Entwicklungsstand.
Part number 8-963964-8 ist nicht freigegeben für serienproduktion

Tabelle 3
TABLE 34805 (3/11)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2-963964-3](#)